

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零一七年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2017年11月7日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一七年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

### 二零一七年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入達2.099億美元，再創歷史新高，環比增長6.0%，同比增長13.3%。
- 毛利率增至35.2%，環比上升2.0個百分點，同比上升4.1個百分點。
- 期內溢利3,530萬美元，環比上升2.9%，同比上升18.5%。
- 每股盈利0.03美元，環比和同比均持平。
- 淨資產收益率2.2%。

### 二零一七年第四季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長約3%。
- 我們預計毛利率在33%至34%之間。

本公司總裁兼執行董事王煜先生對第三季度業績評論道：

“二零一七年第三季度是本公司歷史上表現最為強勁的一個季度。銷售收入達 2.099 億美元，再創歷史新高，環比增長 6.0%，同比增長 13.3%。毛利率增至 35.2%，環比上升 2.0 個百分點，同比上升 4.1 個百分點。淨利潤環比上升 2.9%。這些卓越的表現主要歸功於產品平均銷售價格的提升、產品組合的優化、極高的產能利用率以及持續的利潤突破。銷售收入和毛利率均再次超越指引。”

“為了滿足持續超過產能的強勁需求，尤其是在智能卡芯片、MCU、超級結和 IGBT 等產品領域，公司將致力於增加投資來擴充產能，以滿足客戶要求。我們正在研討擴產方案，將在完成內部評估後對外宣布我們的決定。”王煜先生說道。

## 電話會議公告

日期：二零一七年十一月八日

時間：下午 04:00（上海 / 香港）  
上午 03:00（紐約，2017 年 11 月 8 日）

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 或

[https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017\\_q3\\_earnings\\_call](https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017_q3_earnings_call)

電話詳細：	國際	+65 6713 5521
	中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
	香港	+852 3018 6768
	臺灣	+886 277 031 751
	紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 4597007

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 [http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 網頁上，重複收聽會議。

## 關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

**經營業績概要**  
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	209,928	198,068	185,284	6.0 %	13.3 %
銷售成本	(135,960)	(132,401)	(127,749)	2.7 %	6.4 %
<b>毛利</b>	<b>73,968</b>	<b>65,667</b>	<b>57,535</b>	<b>12.6 %</b>	<b>28.6 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>35.2%</b>	<b>33.2 %</b>	<b>31.1%</b>	<b>2.0</b>	<b>4.1</b>
經營開支	(29,336)	(27,371)	(25,673)	7.2 %	14.3 %
其他收入淨額	4,438	2,174	4,796	104.1 %	(7.5)%
<b>稅前溢利</b>	<b>49,070</b>	<b>40,470</b>	<b>36,658</b>	<b>21.3 %</b>	<b>33.9 %</b>
所得稅開支	(13,729)	(6,117)	(6,837)	124.4 %	100.8 %
<b>期內溢利</b>	<b>35,341</b>	<b>34,353</b>	<b>29,821</b>	<b>2.9 %</b>	<b>18.5 %</b>
淨利潤率	<b>16.8%</b>	<b>17.3 %</b>	<b>16.1%</b>	<b>(0.5)</b>	<b>0.7</b>
每股盈利					
基本	0.03	0.03	0.03	-	-
攤薄	0.03	0.03	0.03	-	-
付運晶圓(仟片)	477	459	467	3.9 %	2.1 %
產能利用率 <sup>1</sup>	99.8 %	99.4 %	100.7 %	0.4	(0.9)
淨資產收益率 <sup>2</sup>	2.2 %	2.2 %	2.0 %	-	0.2

- 銷售收入 2.099 億美元，再創歷史新高，環比增長 6.0%，同比增長 13.3%。
- 銷售成本 1.360 億美元，環比上升 2.7%，同比上升 6.4%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加所致。
- 毛利率 35.2%，環比上升 2.0 個百分點，同比上升 4.1 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及產品組合優化。
- 經營開支 2,930 萬美元，環比上升 7.2%，同比上升 14.3%，主要由於人工費用增加及人民幣升值所致。
- 其他收入淨額 440 萬美元，環比上升 104.1%，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利上升，及(ii)獲得的政府補貼增加，部分被匯兌損失增加所抵消。
- 所得稅開支 1,370 萬美元，環比上升 124.4%，主要由於計提股利代扣代繳稅金增加所致。
- 期內溢利 3,530 萬美元，環比上升 2.9%，同比上升 18.5%。
- 淨利潤率 16.8%，環比下降 0.5 個百分點，同比上升 0.7 個百分點。
- 每股盈利 0.03 美元，環比同比均持平。
- 淨資產收益率 2.2%。

<sup>1</sup> 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup> 期內溢利/加權平均淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	204,516	97.4 %	194,502	98.2 %	10,014	5.1 %
其他	5,412	2.6 %	3,566	1.8 %	1,846	51.8 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>209,928</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>11,860</b>	<b>6.0 %</b>

- 本季度 97.4% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 <sup>3</sup>	116,530	55.6 %	111,180	56.2 %	5,350	4.8 %
美國	37,887	18.0 %	31,351	15.8 %	6,536	20.8 %
亞洲 <sup>4</sup>	26,281	12.5 %	21,218	10.7 %	5,063	23.9 %
日本 <sup>5</sup>	14,657	7.0 %	14,943	7.5 %	(286)	(1.9)%
歐洲	14,573	6.9 %	19,376	9.8 %	(4,803)	(24.8)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>209,928</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>11,860</b>	<b>6.0 %</b>

- 本季度來自中國的銷售收入 1.165 億美元，占銷售收入總額的 55.6%，環比增長 4.8%，主要得益於模擬、邏輯、MCU 和超級結產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,790 萬美元，環比增長 20.8%，主要得益於超級結、通用 MOSFET、閃存、邏輯、MCU 和電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,630 萬美元，環比增長 23.9%，主要得益於邏輯、超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,460 萬美元，環比減少 24.8%，主要由於智能卡芯片和通用 MOSFET 產品的需求減少所致。

<sup>3</sup>包括香港。

<sup>4</sup>不包括中國及日本。

<sup>5</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	75,832	36.1 %	81,033	41.0 %	(5,201)	(6.4)%
分立器件	57,872	27.6 %	52,391	26.5 %	5,481	10.5 %
模擬與電源管理	39,761	18.9 %	35,935	18.1 %	3,826	10.6 %
邏輯及射頻	28,471	13.6 %	22,187	11.2 %	6,284	28.3 %
獨立非易失性存儲器	7,600	3.6 %	6,041	3.0 %	1,559	25.8 %
其他	392	0.2 %	481	0.2 %	(89)	(18.5)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>209,928</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>11,860</b>	<b>6.0 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 7,580 萬美元，環比減少 6.4%，主要由於智能卡芯片的需求減少所致，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 5,790 萬美元，環比增長 10.5%，主要得益於超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,980 萬美元，環比增長 10.6%，主要得益於模擬、LED 照明和其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度邏輯和射頻銷售收入 2,850 萬美元，環比增長 28.3%，主要得益於邏輯產品需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 760 萬美元，環比增長 25.8%，主要得益於閃存產品需求增加。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	二零一七年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第二季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	69,559	33.1 %	63,734	32.2 %	5,825	9.1 %
0.15μm 及 0.18μm	39,462	18.8 %	34,502	17.4 %	4,960	14.4 %
0.25μm	3,744	1.8 %	5,194	2.6 %	(1,450)	(27.9)%
0.35μm 及以上	97,163	46.3 %	94,638	47.8 %	2,525	2.7 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>209,928</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0 %</b>	<b>11,860</b>	<b>6.0 %</b>

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 6,960 萬美元，環比增長 9.1%，主要得益於邏輯、MCU 和閃存產品需求增加。
- 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,950 萬美元，環比增長 14.4%，主要得益於邏輯和模擬產品需求增加。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 370 萬美元，環比減少 27.9%，主要由於智能卡芯片和通用 MOSFET 產品需求減少。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 9,720 萬美元，環比增長 2.7%，主要得益於超級結、通用 MOSFET 和其他電源管理產品需求增加，部分被智能卡芯片需求減少所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一七年	二零一七年	二零一七年	二零一七年	環比	環比
	第三季度 仟美元 (未經審核)	第三季度 %	第二季度 仟美元 (未經審核)	第二季度 %	仟美元	%
電子消費品	144,402	68.8 %	133,870	67.6%	10,532	7.9 %
工業及汽車	28,879	13.8 %	26,145	13.2%	2,734	10.5 %
通訊	26,089	12.4 %	28,994	14.6%	(2,905)	(10.0)%
計算機	10,558	5.0 %	9,059	4.6%	1,499	16.5 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>209,928</b>	<b>100.0 %</b>	<b>198,068</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,860</b>	<b>6.0 %</b>

- 本季度電子消費品仍然是我們第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.444 億美元，占銷售收入總額的 68.8%，環比增長 7.9%，主要得益于邏輯和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 2,890 萬美元，環比增長 10.5%，主要得益于智能卡芯片和超級結產品的需求增加，部分被通用 MOSFET 和 MCU 產品的需求減少所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,610 萬美元，環比減少 10.0%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,060 萬美元，環比增長 16.5%，主要得益于通用 MOSFET 和閃存產品需求增加。

產能<sup>6</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	63	60	56
2 號晶圓廠	57	57	57
3 號晶圓廠	46	42	40
<b>合計</b>	<b>166</b>	<b>159</b>	<b>153</b>
<i>產能利用率</i>	<i>99.8%</i>	<i>99.4%</i>	<i>100.7%</i>

- 由于客戶需求強勁，產能利用率由上季度的 99.4 % 上升至本季度的 99.8%。由于 1 號和 3 號晶圓廠的擴產產能釋放，本季度末合計產能增至每月 166 仟片晶圓。

<sup>6</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

仟片晶圓	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	477	459	467	3.9 %	2.2 %

- 本季度付運晶圓 477 仟片，環比增加 3.9%，主要由於客戶需求增加。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,826	1,753	1,633	4.2%	11.8%
管理費用 <sup>7</sup>	27,510	25,618	24,040	7.4%	14.4%
<b>經營開支</b>	<b>29,336</b>	<b>27,371</b>	<b>25,673</b>	<b>7.2%</b>	<b>14.3%</b>

- 經營開支 2,930 萬美元，環比上升 7.2%，同比上升 14.3%，主要由於人工費用增加及人民幣升值所致。

### 其他收入淨額分析

以千美元計	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,607	3,299	2,842	9.3 %	26.9 %
利息收入	1,819	1,533	1,214	18.7 %	49.8 %
匯兌損失	(3,235)	(2,689)	(370)	20.3 %	774.3 %
分佔一家聯營公司溢利	1,248	157	182	694.9 %	585.7 %
財務費用	(557)	(534)	(1,016)	4.3 %	(45.2)%
政府補貼	1,429	210	1,590	580.5 %	(10.1)%
其他	127	198	354	(35.9)%	(64.1)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>4,438</b>	<b>2,174</b>	<b>4,796</b>	<b>104.1 %</b>	<b>(7.5)%</b>

- 其他收入淨額 440 萬美元，環比上升 104.1%，主要由於(i)分佔一家聯營公司溢利上升，及(ii)獲得的政府補貼增加，部分被匯兌損失增加所抵消。

<sup>7</sup>管理費用包括確認為研發開支抵銷項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)	二零一六年 第三季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	75,394	64,575	45,694	16.8 %	65.0 %
投資活動所用現金流量淨額	(76,675)	(114,525)	(124,414)	(33.0)%	(38.4)%
融資活動所用現金流量淨額	(556)	(40,236)	(1,008)	(98.6)%	(44.8)%
外匯匯率變動影響淨額	4,253	3,835	(2,995)	10.9 %	(242.0)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>2,416</b>	<b>(86,351)</b>	<b>(82,723)</b>	<b>(102.8)%</b>	<b>(102.9)%</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 7,540 萬美元，環比上升 16.8%，主要得益於貿易應收款項及應收票據的回收增加所致。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 7,670 萬美元，其中包括(i) 定期存款投資支出 4,420 萬美元，(ii) 設備投資支出 3,380 萬美元，部分被利息收入 130 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 60 萬美元，系銀行貸款利息支出。

### 資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)
資產總額	1,989,929	1,900,935
負債總額	365,559	345,672
所有者權益總額	1,624,370	1,555,263
資產負債率 <sup>8</sup>	18.4%	18.2%

### 資本開支

以千美元計	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一七年 第二季度 (未經審核)
資本開支	33,757	43,329

- 本季度資本開支 3,380 萬美元，上季度為 4,330 萬美元。

<sup>8</sup> 資產負債率=負債總額/資產總額。



## 流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)
存貨	115,500	100,875
貿易應收款項及應收票據	110,624	107,565
預付款項、按金及其他應收款項	12,943	11,836
應收關聯方款項	46,217	53,013
已凍結存款及定期存款	246,931	202,834
現金及現金等價物	243,853	241,437
<b>流動資產總額</b>	<b>776,068</b>	<b>717,560</b>
貿易應付款項	66,978	60,999
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	114,707	116,474
計息銀行借款	4,219	4,133
政府補助	41,572	38,880
應付關聯方款項	14,264	16,223
應付所得稅	23,806	16,259
<b>流動負債總額</b>	<b>265,546</b>	<b>252,968</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>510,522</b>	<b>464,592</b>
速動比率	2.5x	2.4x
流動比率	2.9x	2.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	51	55
存貨周轉天數	72	67

- 存貨由上季度末的 1.009 億美元上升至本季度末的 1.155 億美元，主要由於客戶訂單增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 5,300 萬美元下降至本季度末的 4,620 萬美元，主要由於關聯客戶的應收款回收增加。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 2.028 億美元上升至本季度末的 2.469 億美元，主要由於本季度增加了 4,420 萬美元的定期存款。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,620 萬美元下降至本季度末的 1,430 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 1,630 萬美元上升至本季度末的 2,380 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 5.105 億美元，流動比率 2.9。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 51 天，上季度為 55 天。
- 本季度存貨周轉天數為 72 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)
銷售收入	209,928	198,068	185,284
銷售成本	(135,960)	(132,401)	(127,749)
<b>毛利</b>	<b>73,968</b>	<b>65,667</b>	<b>57,535</b>
其他收入及收益	7,049	5,240	6,001
銷售及分銷費用	(1,826)	(1,753)	(1,633)
管理費用	(27,510)	(25,618)	(24,040)
其他費用	(3,302)	(2,689)	(371)
財務費用	(557)	(534)	(1,016)
分佔一家聯營公司溢利	1,248	157	182
<b>稅前溢利</b>	<b>49,070</b>	<b>40,470</b>	<b>36,658</b>
所得稅開支	(13,729)	(6,117)	(6,837)
<b>期內溢利</b>	<b>35,341</b>	<b>34,353</b>	<b>29,821</b>
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	35,341	34,353	29,821
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.03	0.03	0.03
攤薄	0.03	0.03	0.03
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>1,034,043,768</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>1,033,871,656</b>
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	<b>1,043,395,768</b>	<b>1,043,950,656</b>	<b>1,037,949,656</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	737,713	714,933	689,290
投資物業	176,718	173,132	175,562
預付土地租賃款項	20,481	20,228	21,015
無形資產	8,002	8,282	7,427
於聯營公司的投資	48,258	46,059	42,866
可供出售投資	212,524	208,210	211,222
長期預付款項	2,801	5,434	4,639
遞延稅項資產	7,364	7,097	5,691
<b>非流動資產總額</b>	<b>1,213,861</b>	<b>1,183,375</b>	<b>1,157,712</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	115,500	100,875	98,760
貿易應收款項及應收票據	110,624	107,565	110,947
預付款項、按金及其他應收款項	12,943	11,836	14,554
應收關聯方款項	46,217	53,013	43,895
已凍結存款及定期存款	246,931	202,834	115,677
現金及現金等價物	243,853	241,437	375,186
<b>流動資產總額</b>	<b>776,068</b>	<b>717,560</b>	<b>759,019</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	66,978	60,999	65,173
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	114,707	116,474	79,505
計息銀行借款	4,219	4,133	42,750
政府補助	41,572	38,880	47,116
應付關聯方款項	14,264	16,223	11,416
應付所得稅	23,806	16,259	19,968
<b>流動負債總額</b>	<b>265,546</b>	<b>252,968</b>	<b>265,928</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>510,522</b>	<b>464,592</b>	<b>493,091</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>1,724,383</b>	<b>1,647,967</b>	<b>1,650,803</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	90,061	89,373	136,797
遞延稅項負債	9,952	3,331	7,450
<b>非流動負債總額</b>	<b>100,013</b>	<b>92,704</b>	<b>144,247</b>
<b>淨資產</b>	<b>1,624,370</b>	<b>1,555,263</b>	<b>1,506,556</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,550,820	1,550,164	1,550,164
儲備	73,550	5,099	(43,608)
<b>權益總額</b>	<b>1,624,370</b>	<b>1,555,263</b>	<b>1,506,556</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於六月三十日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一六年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量：</b>			
稅前溢利	49,070	40,470	36,658
折舊及攤銷	27,717	25,153	21,166
應佔聯營公司溢利	(1,248)	(157)	(182)
營運資金的變動及其它	(145)	(891)	(11,948)
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>75,394</b>	<b>64,575</b>	<b>45,694</b>
<b>投資活動所用現金流量：</b>			
購買物業、廠房及設備項目	(33,757)	(43,329)	(53,800)
其他投資活動所用的現金流量	(42,918)	(71,196)	(70,614)
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(76,675)</b>	<b>(114,525)</b>	<b>(124,414)</b>
<b>融資活動所用現金流量：</b>			
向股東支付股息	(19)	(39,673)	(20,517)
已凍結存款的減少/(增加)	19	(25)	20,517
已付利息	(556)	(538)	(1,008)
<b>融資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(556)</b>	<b>(40,236)</b>	<b>(1,008)</b>
現金及現金等價物減少淨額	(1,837)	(90,186)	(79,728)
外匯匯率變動影響淨額	4,253	3,835	(2,995)
期初現金及現金等價物	241,437	327,788	457,909
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>243,853</b>	<b>241,437</b>	<b>375,186</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

王煜(總裁)

**非執行董事**

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一七年十一月七日